

2005年8月8日

半導体用ダイボンディングフィルムの生産能力を50%増強

—技術力と知的財産の両面から事業を強化—

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153億円)は、フラッシュメモリー等のスタックド・マルチチップ・パッケージ(スタックドMCP)向けに今後大幅な需要の拡大が見込まれる「ダイボンディングフィルム」の生産能力を2006年9月までに段階的に約50%増強します。

デジタルカメラをはじめとする電子機器の軽薄短小化の進展及びカメラ付き携帯電話に代表される多機能化に伴い、半導体デバイスは、ロジックにおける高速化、メモリにおける大容量化が求められており、半導体パッケージの構造には、実装面積をより小さく、より高密度にできるスタックドMCPの採用が急速に進んでいます。

スタックドMCPとは、複数の薄型化した半導体チップを積層(スタック)したもので、これまでの2段や3段スタックに加え、最近では4段、5段とさらに高積層化が進められており、これらの接続には、ウエハバックグラインド工程後にそのままウエハ裏面に貼り付けが可能で、ダイシング後の実装が容易なダイボンディングフィルムの需要が急速に高まっています。

当社では、これら高積層化に伴う市場のニーズに対応するため、熱サイクル性や耐湿性、耐はんだリフローなど半導体パッケージの信頼性を向上させることができるフィルムを生産し顧客に供給しているほか、顧客のパッケージ製造工程短縮のためダイシングテープとダイボンディングフィルムの機能を併せ持つダイシング・ダイボンド一体型フィルムを供給するなど幅広い製品を提供し、売上を拡大してきました。

今般当社は、五井事業所(千葉県市原市)に約10億円を投じ、2006年9月までに製造ラインを段階的に増設して、生産能力を現在の約50%増にあたる年間約120万㎡に拡大します。

また、当社ではダイボンディングフィルム分野において、前述したパッケージ信頼性を達成するために必要不可欠と考えられるフィルム物性特許や、材料・パッケージに関する特許を含む約500件の多面的な特許網(特許出願中を含む)を国内外に有し、技術力と知的財産の充実の両面から顧客の満足を得ると共に事業の強化を図る方針です。

(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 金成 TEL 03-5381-2374